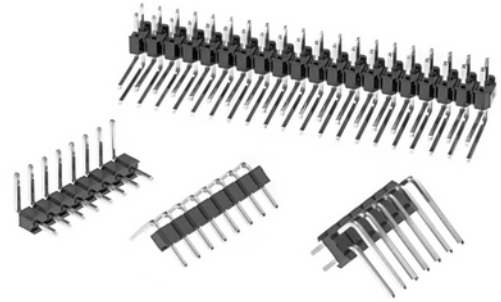


## Stiftleisten RM 2,54mm, steckseitig gewinkelt, 1-/2-reihig Pin Headers, 2.54mm Pitch, Right-Angled Mating Side, Single/Double Row

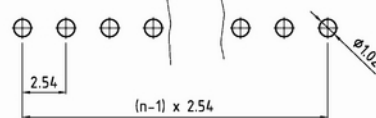
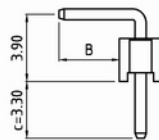
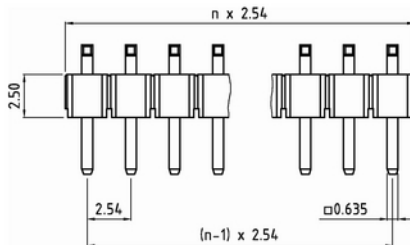
### Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper	Thermoplastischer Kunststoff, nach UL94 V-0
Insulator	Thermoplastic, rated UL94 V-0
Kontaktmaterial	Vierkantstift 0,635mm, Kupferlegierung
Contact Material	0.635mm square pin, copper alloy
Kontaktoberfläche	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni (1,3 ... 2,5µm)
Contact Surface	Acc. to options (see below), over Ni (1.3 ... 2.5µm)
Lötbarkeit	IEC 60512-12A
Solderability	IEC 60512-12A
Durchgangswiderstand	< 20mΩ
Contact Resistance	< 20mΩ
Isolationswiderstand	> 1000MΩ
Insulation Resistance	> 1000MΩ
Spannungsfestigkeit	1kV <sub>DC</sub>
Test Voltage	1kV <sub>DC</sub>
Nennspannung	250V <sub>AC</sub>
Voltage Rating	250V <sub>AC</sub>
Nennstrom	3A
Current Rating	3A
Temperaturbereich	-40°C ... +125°C
Temperature Range	-40°C ... +125°C
Verarbeitung	Wellen- oder Reflow-Lötverfahren
Processing	Wave or reflow soldering

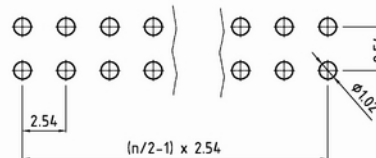
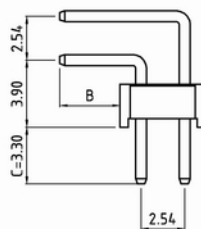
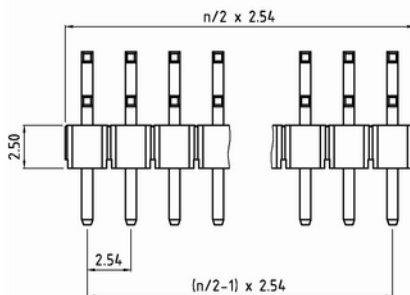


© W+P PRODUCTS

Passende Buchsenleisten:  
Mate with Female Headers:  
**153 154 157 159 160/162 349 624** etc.  
Weitere siehe Kapitel B  
Please see ch. B for more



PCB Layouts



### Series\*

**246**

**Gestanzte/geprägte Kontakte**  
Stamped/formed contacts  
**246** Einreihig  
Single row  
**247** Zweireihig  
Double row

### Dimensions\*

**12**

**12** B=3,50mm  
**13** B=4,80mm  
**14** B=6,10mm  
**15** B=6,90mm  
**16** B=9,90mm  
**17** B=12,00mm  
**18** B=13,80mm  
**19** B=15,00mm  
**20** B=17,10mm  
**99** Kundenspezifisch  
Customer-specific

### Contacts\*

**050**

**001-050** Einreihig  
Single row  
**004-100** Zweireihig  
Double row

### Plating\*

**00**

**00** Vergoldet  
Gold plated  
**50** Verzinkt  
Tin plated  
**60** Sel. Au/Sn  
Duplex plating

Weitere Abmessungen auf Anfrage.  
More dimensions on request.

\* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -  
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.  
\* This is an **order example** -  
please replace by your specifications.

## Informationen zum Wellen-Lötverfahren Wave Soldering Information

### Empfehlungen für das Wellenlötverfahren Recommendations for Wave Soldering

Die Bauteile sollten bei einer Lötbadtemperatur von 260°C in max. 5 Sekunden verlötet werden.  
*Items should be soldered at a solder temperature of 260°C in 5 seconds max.*

Empfohlenes Wellenlötprofil:  
*Recommended wave soldering profile:*



## Informationen zum Reflow-Lötverfahren Reflow Soldering Information

### Reflow-Löttempfehlung Reflow Soldering Recommendation

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum $T_{Smin}$	150°C
Temperatur Maximum $T_{Smax}$	200°C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Temperatur Lötbereich $T_L$	217°C
Verweildauer oberhalb $T_L$	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Höchsttemperatur $T_P$	260°C ±5
Dauer Höchsttemperatur	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Dauer 25°C - Höchsttemperatur $T_P$	Max. 8 min

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature $T_{Smin}$	150°C
Maximum Temperatur $T_{Smax}$	200°C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Soldering Range Temperature $T_L$	217°C
Duration above $T_L$	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Peak Temperature $T_P$	260°C ±5
Duration Peak Temperature	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Duration 25°C - Peak Temp. $T_P$	Max. 8min

